

精密锡球熔滴焊接系统

WL-1K15/50-F系列



精密锡球熔滴焊接系统

产品介绍

激光通过光纤传输，输出口安装于锡球出口上方，在环形腔体上设置有供高压气进入的入口，通过激光融化锡球，然后高压惰性气体可保证有足够的压力将融化的锡球滴落，又可以保证熔化的锡焊不会被氧化，焊接精度高，焊接效果好，尤其适用于极高精度的焊锡需求。

产品特点

- 锡球焊接适用于精度非常高，加工材质对于温度比较敏感，不适宜于直接加工；
- 锡球的范围较大，锡球直径从 $50\mu\text{m}$ ~ $760\mu\text{m}$ ，适用于这个范围要求内的精密焊接；
- 加热、熔滴过程快捷，可在0.2s内完成；
- 在焊嘴内完成锡球熔化，无飞溅；
- 不需助焊剂、无污染，最大限度保证电子器件寿命；
- 锡球直径最小0.05mm，符合小型化发展趋势；
- 可通过锡球大小的选择完成不同焊点的焊接；
- 良品率高；
- 配合图像定位系统适合流水线大批量生产。

应用领域

本设备可用于晶圆、光电子产品、MEMS、产品传感器、BGA、HDD (HGA、HSA)、相机模块的焊接。

样品展示

